

疫情下，全球半导体趋势到底如何？

数据库专题跟踪系列

报告日期：2020/05/23

国信电子首席：欧阳仕华 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980517080002

国信电子分析师：唐泓翼 证券投资咨询执业资格证书编码：S0980516080001

【半导体数据库|国信电子】包含3个专题/11个分录/10万+数据，深入洞察产业链趋势



国信证券经济研究所

GUOSEN SECURITIES ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE

共度时艰，中长期看好中国半导体崛起趋势不变

■ 先行指标显现20年全球半导体拐点已现，国内半导体需求仍旧强劲。

- 1、全球半导体行业拐点在2019年底已经出现拐点，上中下游各环节增速在提升。3月数据：北美、日本设备金额出货同比分别为26.7%、8.2%；日本硅片出货单价同比+3.8%；全球半导体销售额同比+8%。
- 2、虽然在疫情影响下，产业龙头公司英特尔、台积电、中芯国际以及安靠等Q2收入指引为正增长。

■ 关注国内射频、核心材料、存储等独立趋势机会。

4月台湾半导体龙头数据亮眼，晶圆代工、封测、存储及射频领域龙头受疫情影响较小，考虑疫情阶段，国内产业链将集中资源围绕5G及产业链自主可控等强化建设，关注国内射频、核心材料、存储等独立趋势机会。

■ 国产半导体的产业持续升级，各产业链细分龙头

【核心设计龙头】：卓胜微，圣邦股份、韦尔股份，兆易创新，汇顶科技、斯达半导等；

【核心制造龙头】：中芯国际、三安光电、华润微等；

【封装测试龙头】：长电科技，华天科技等；

【核心材料龙头】：鼎龙股份，安集科技、沪硅产业等；

【核心设备龙头】：中微公司，北方华创，汉中精机等；

注：以上公司仅做列式，不做推荐

01

国内外重要半导体指数行情

02

半导体上游-全球设备/材料数据跟踪

03

半导体制造-全球及重点公司晶圆制造产能跟踪

04

半导体下游-全球及重点区域销售跟踪

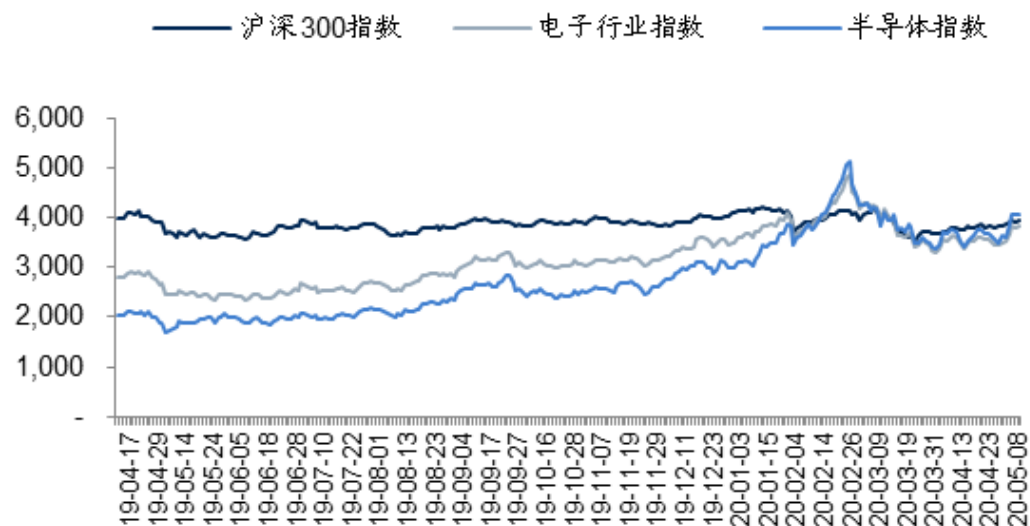
05

全球半导体产业链龙头公司

一、国内外重要半导体指数行情

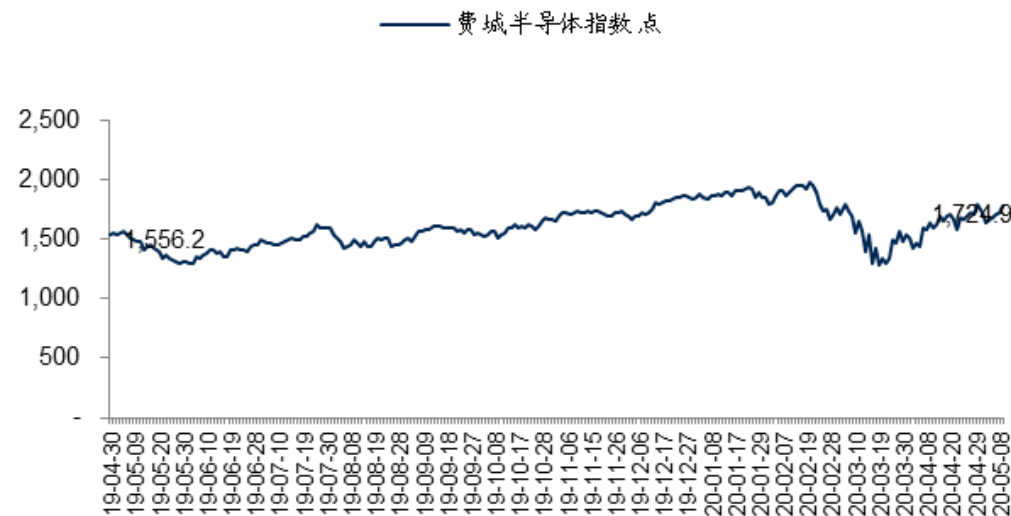
■ 2020-04-08 至 2020-05-08 各主要指标涨跌幅：沪深300指数上涨4.8%，SW电子行业指数上涨5.2%，国内半导体指数上涨8.6%，费城半导体指数上涨9.4%。

图1：沪深/电子/半导体指数



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图2：费城半导体指数



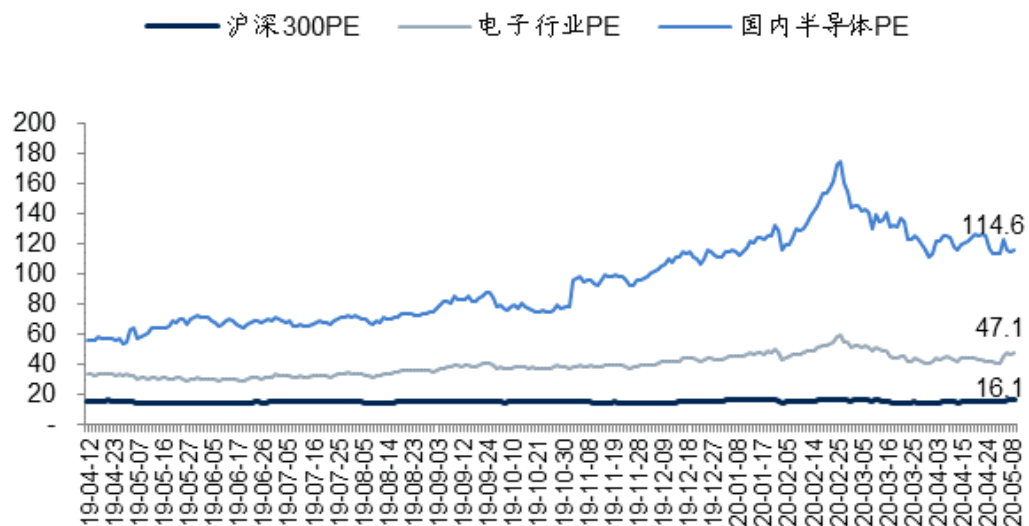
数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

一、国内外重要半导体指数行情

■ 主要市场板块估值

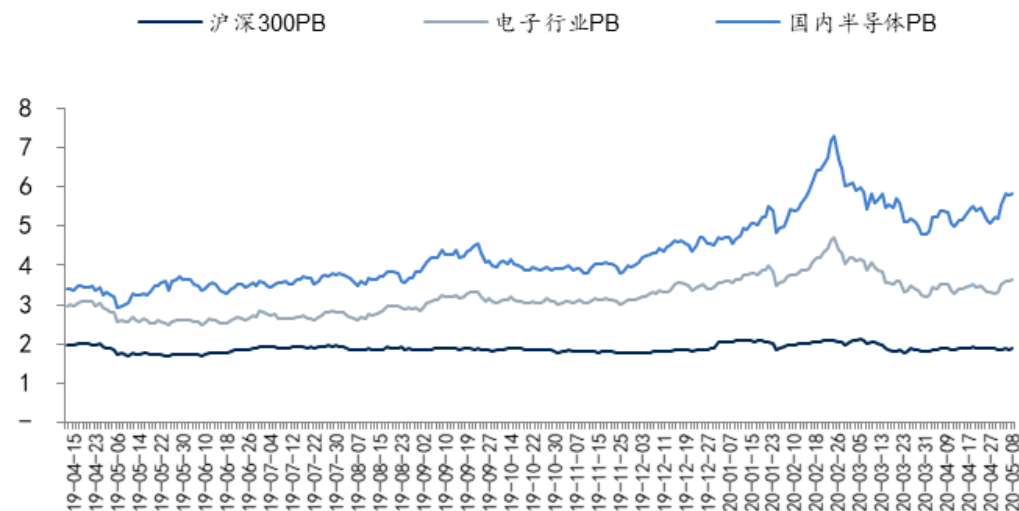
沪深300指数动态PE 16.1倍，SW电子行业指数动态PE 47.1倍，SW半导体行业指数动态PE 115.2倍。
沪深300指数动态PB 1.9倍，SW电子行业指数动态PB 3.6倍，SW半导体行业指数动态PB 5.8倍

图3：沪深/电子/半导体指数 PE



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图4：沪深/电子/半导体指数 PB



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

01

国内外重要半导体指数行情

02

半导体上游-全球设备/材料数据跟踪

03

半导体制造-全球及重点公司晶圆制造产能跟踪

04

半导体下游-全球及重点区域销售跟踪

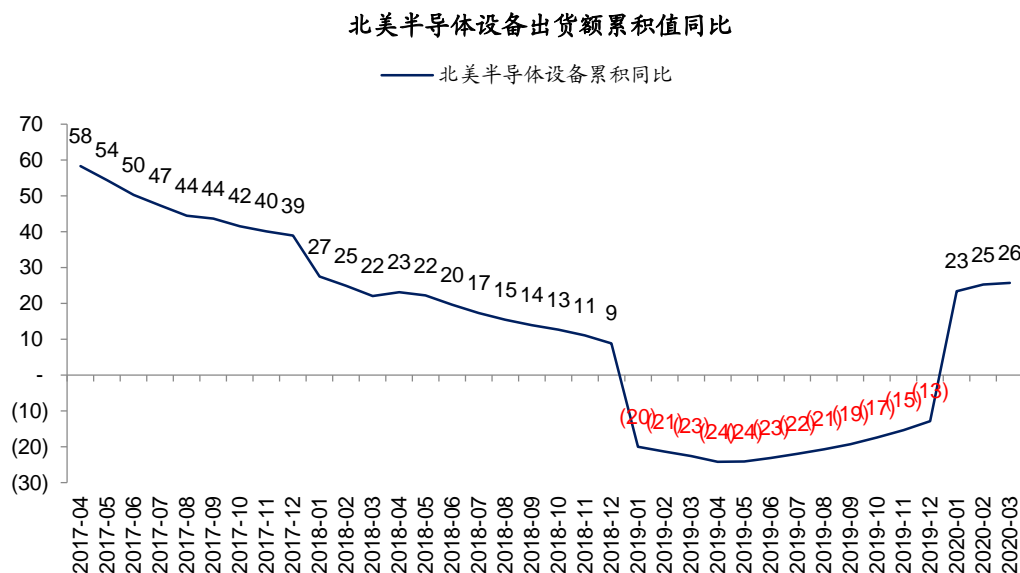
05

全球半导体产业链龙头公司

二、半导体上游-全球设备数据跟踪-北美半导体设备

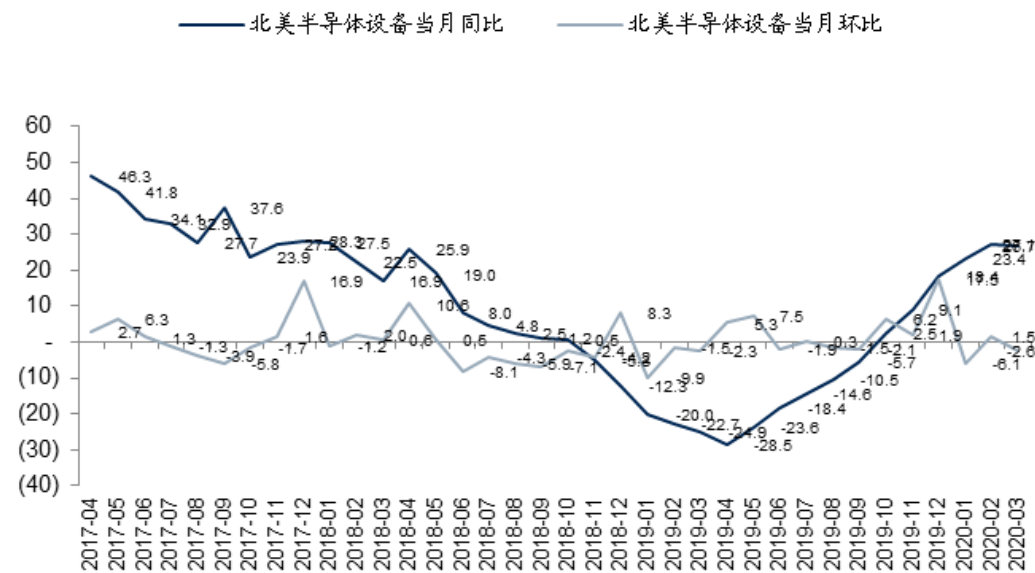
■ 20年03月，北美半导体设备出货额23.1亿美元，同比26.7%，环比-2.6%。20年1-3月，北美半导体设备累积出货额70.3亿美元，同比25.7%。半导体设备已经从2019年5月份出货增速拐点已经出现，并且在2019年11月实现同比正增长。半导体行业先行指标已经显示行业拐点在2019年底出现。

图5：北美半导体设备出货额累积值同比(%)



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图6：北美半导体设备出货当月同比/环比(%)

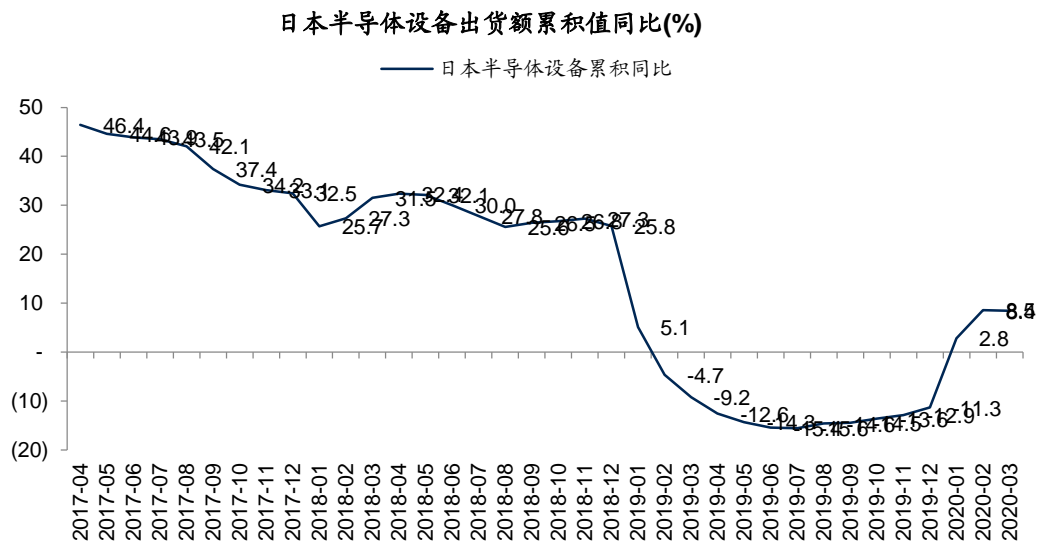


数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

二、半导体上游-全球设备数据跟踪-日本半导体设备

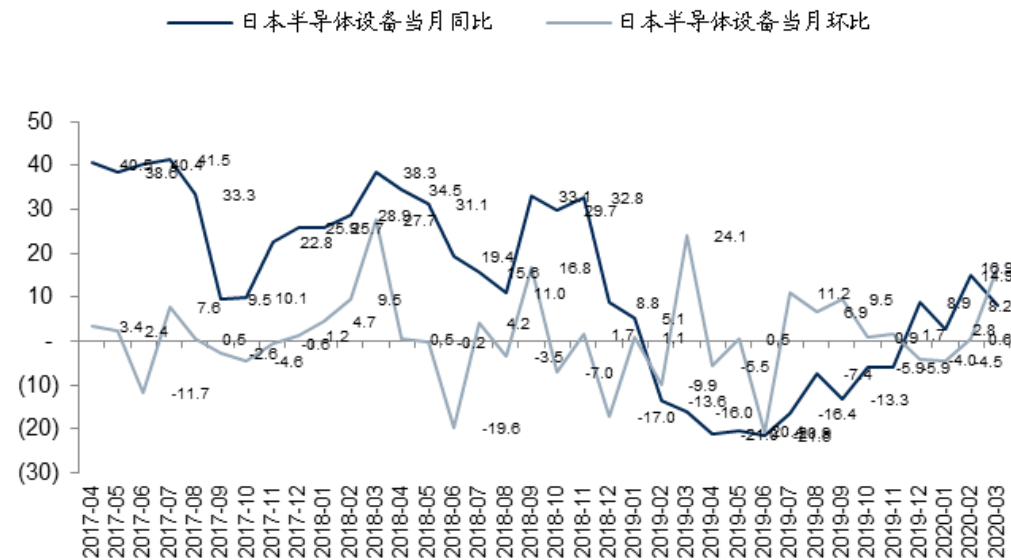
■ 20年03月，日本半导体设备出货额18.3亿美元，同比8.2%，环比16.9%。20年1-3月，日本半导体设备累积出货额49.6亿美元，同比8.4%。

图7：日本半导体设备累积出货额同比(%)



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图8：日本半导体设备出货当月同比/环比(%)



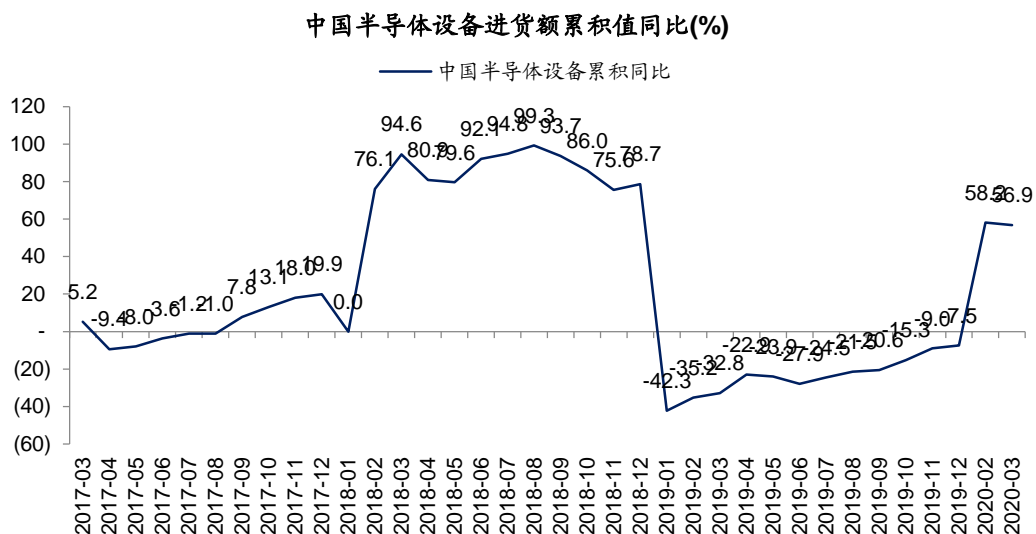
数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

二、半导体上游-全球设备数据跟踪-中国半导体设备进口

中国半导体设备进口继续高速增长，显现产业链继续看好中国需求

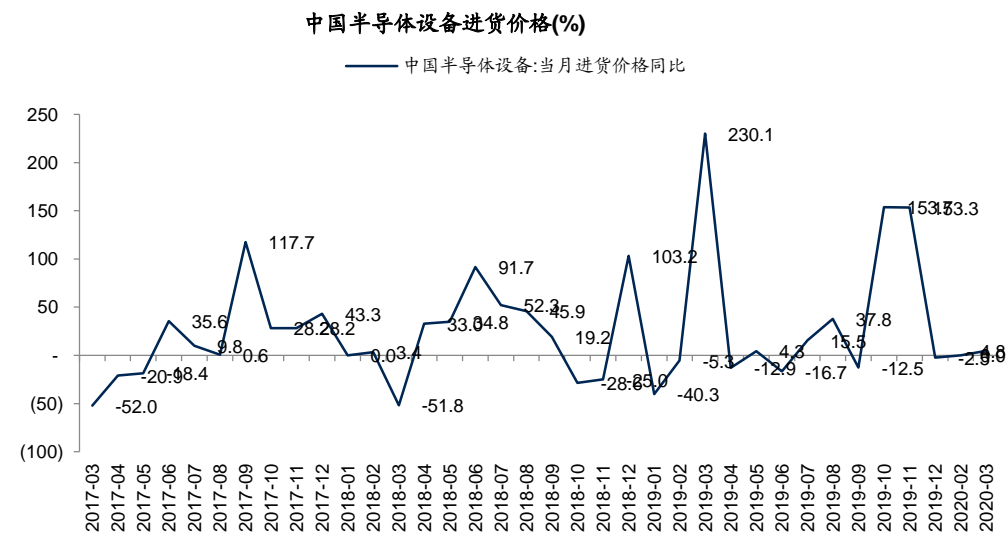
- 20年03月，中国半导体设备进口额11.1亿美元，同比54.4%。20年1-3月，中国半导体设备累积进口额29.0亿美元，同比56.9%。
- 20年03月，中国半导体设备:当月进货平均价格101.3万美元/台，同比4.8%。

图9：中国半导体设备累积进货额同比



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图10：中国半导体设备进货价格同比



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

二、半导体上游-全球材料数据跟踪-日本晶圆总体出口

日本晶圆出口呈现量跌价升

- 20年03月日本晶圆出口价值312.7亿美元，同比-12.5%，环比-6.2%。20年1-3月日本晶圆出口累积价值915.0亿美元，同比-12.5%。
- 20年03月日本晶圆出口量，465.3吨，同比-15.7%。环比-0.8%。20年1-3月晶圆出口量累积量1313.6吨，同比-20.1%。
- 20年03月晶圆出口单位价格：平均当月值6.7万美元/公斤，同比3.8%。

图11: 晶圆出口价值: 总计: 累积值

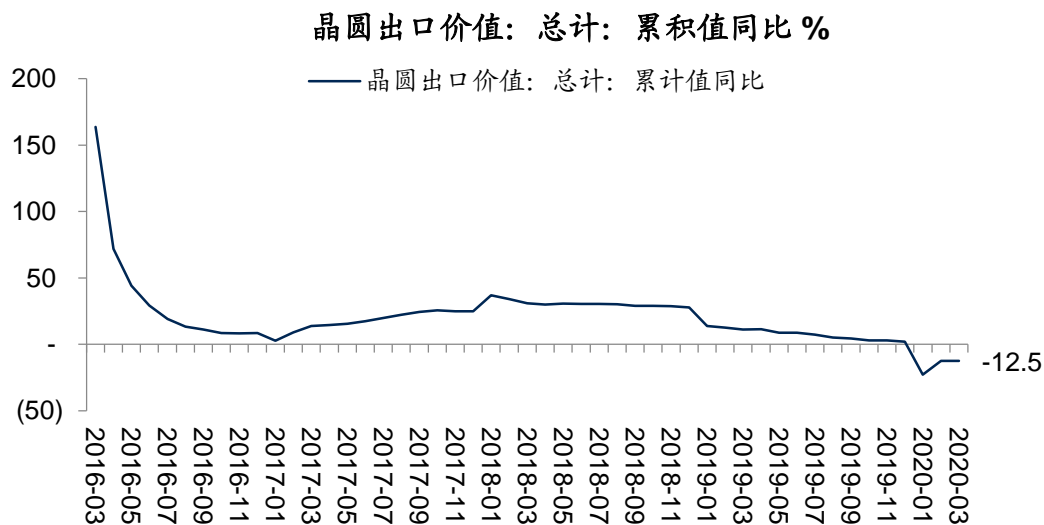
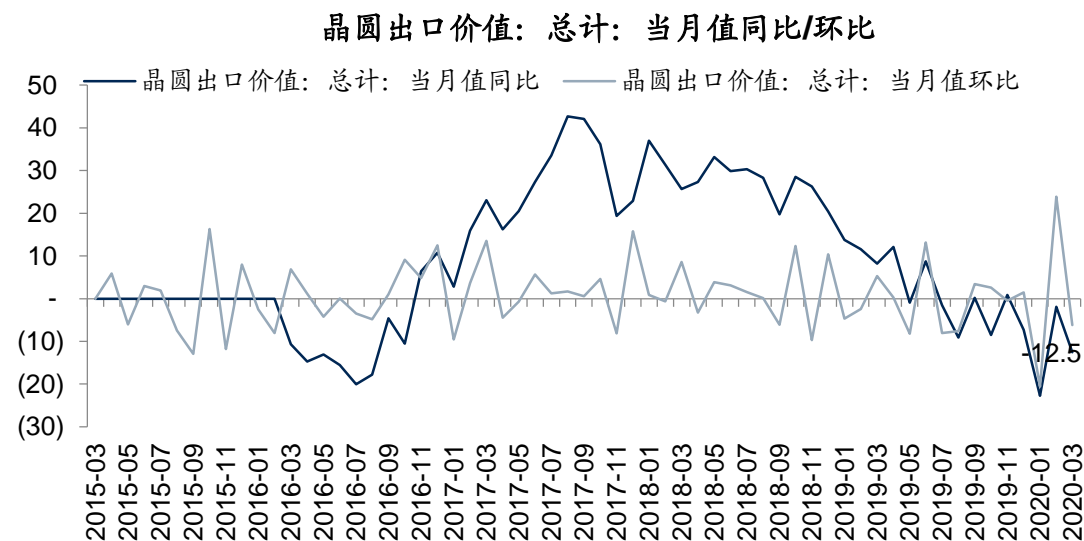


图12: 晶圆出口价值: 总计: 当月值同比/环比



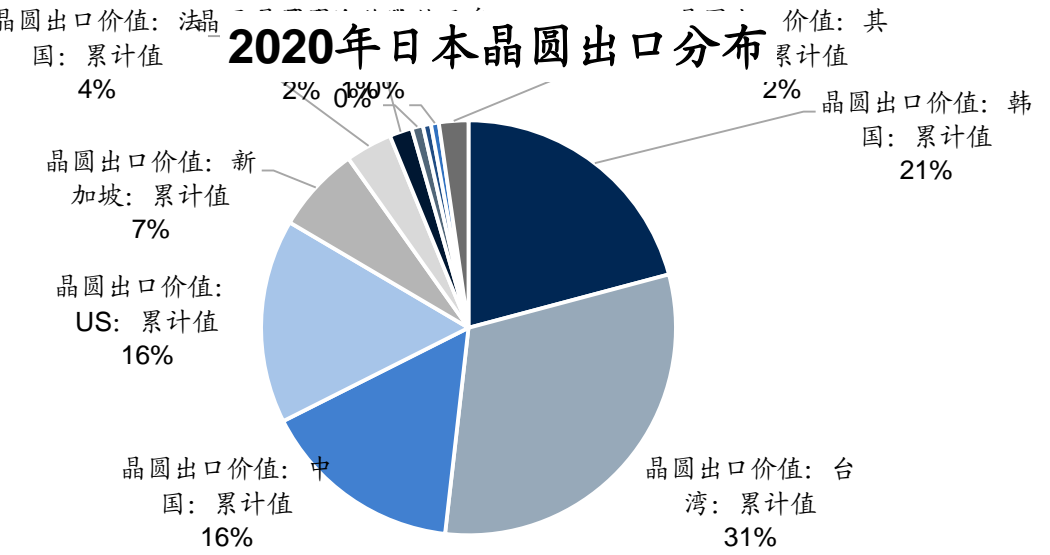
数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

二、半导体上游-全球材料数据跟踪-日本晶圆出口结构

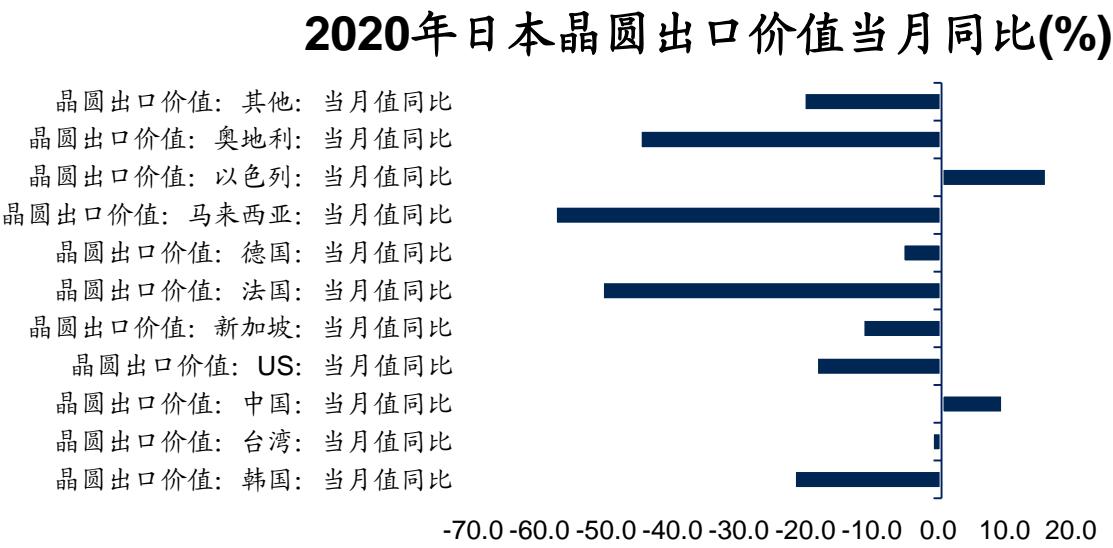
20年1-3月，日本晶圆出口台湾累积占比达31%，为各区域最大，价值 283.2 亿美元，同比增速-3.1%；累积出货量424.8 吨，同比-18.5%。其中3月晶圆价格为9.5万美元/公斤，同比增长2.7%。

图13: 日本晶圆出口累积价值量区域分布



数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图14: 日本晶圆出口地域当月价值同比



数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

二、半导体上游-全球材料数据跟踪-日本晶圆出口大陆

日本晶圆出口中国呈现量跌价升态势，中国制造产业升级叠加疫情影响

- 20年03月日本晶圆出口中国价值53.7亿美元，同比9.3%，环比-13.3%。20年1-3月日本晶圆出口中国累积价值144.3亿美元，同比3.3%。
- 20年03月日本晶圆出口中国74.4吨，同比-4.5%。20年1-3月日本晶圆出口中国累积量203.2吨，同比-10.7%。
- 2020年03月晶圆出口单位价格：中国：当月值6.1万美元/公斤，同比40.6%。

图15：晶圆出口价值：中国：当月值同比/环比(%)

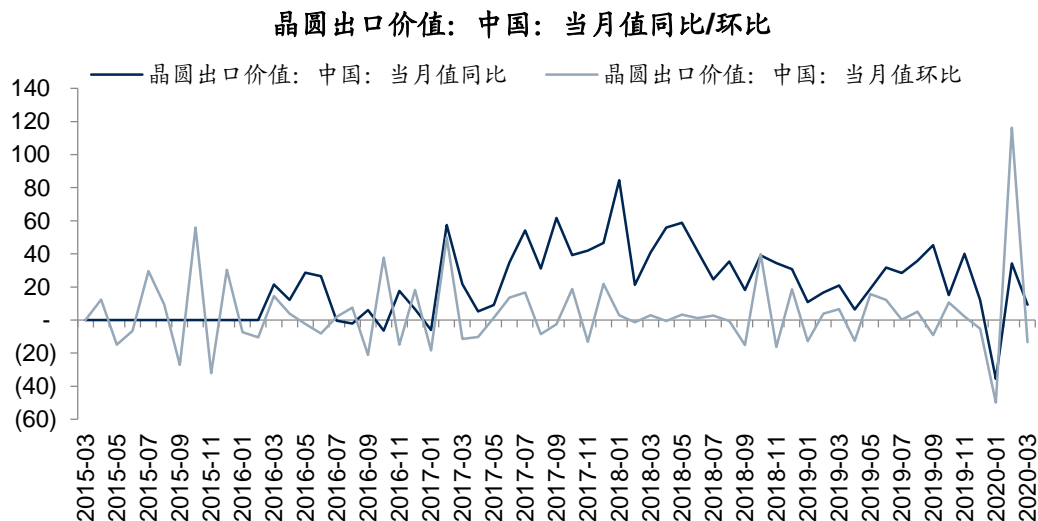


图16：晶圆出口量：中国：当月值同比



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

01

国内外重要半导体指数行情

02

半导体上游-全球设备/材料数据跟踪

03

半导体制造-全球及重点公司晶圆制造产能跟踪

04

半导体下游-全球及重点区域销售跟踪

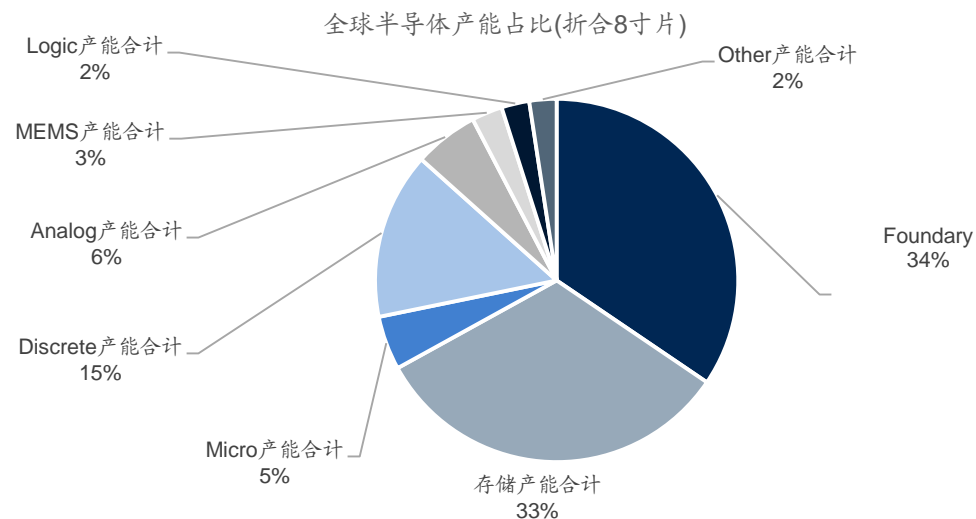
05

全球半导体产业链龙头公司

三、半导体制造-全球晶圆产能分类汇总

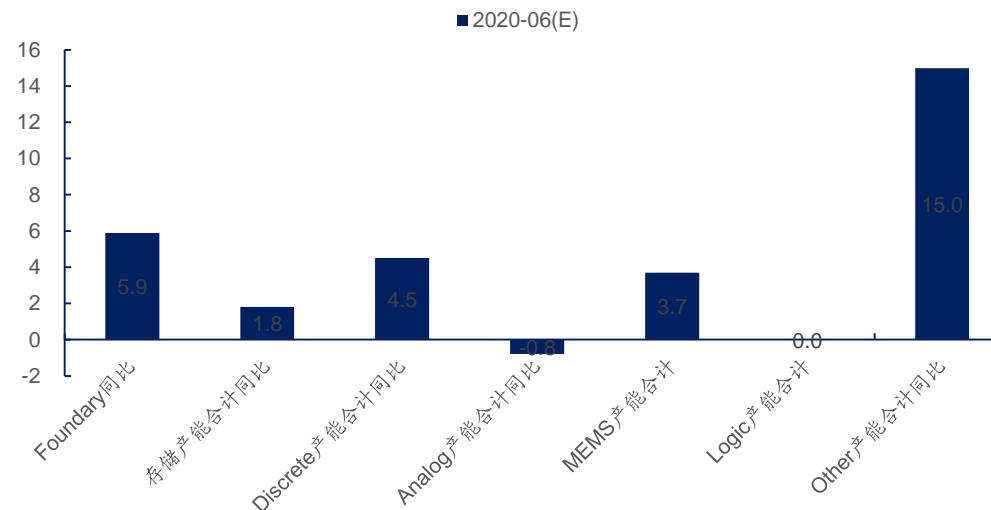
■ **20Q2(E)预计全球半导体产能(折算8吋片) 合计2146.7万片/月，同比3.8%。**其中Foundry产能占比为34.4%，产能740.2万片/月，同比增长5.9%，为各主要分类中产能增长最快，增速比20Q1提升0.3PCT。

图17：全球半导体产能占比



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图18：全球半导体产能同比增速(%)

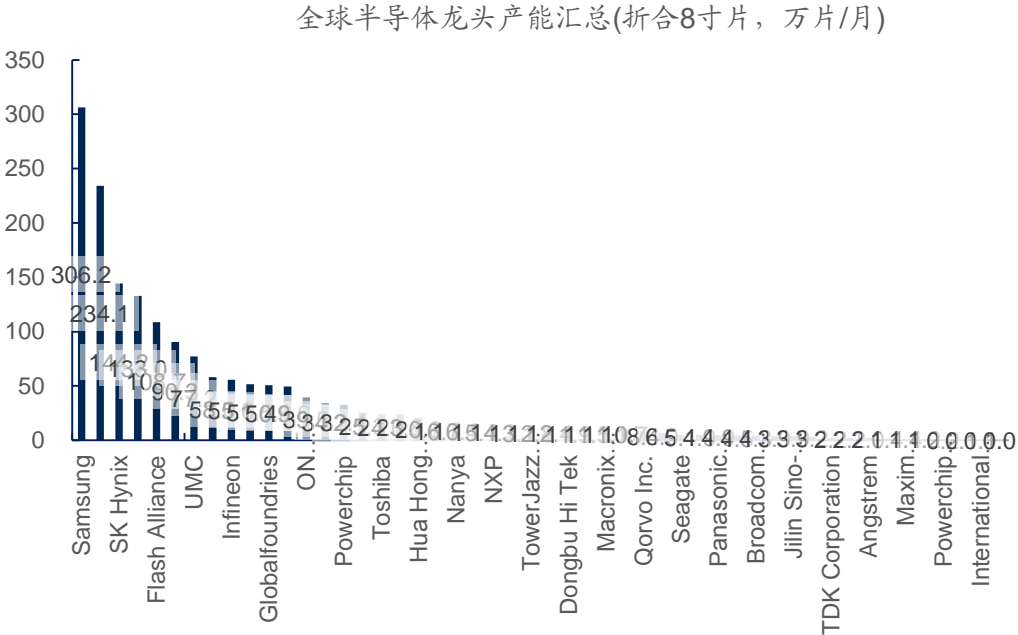


数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

三、半导体制造-全球龙头公司晶圆产能

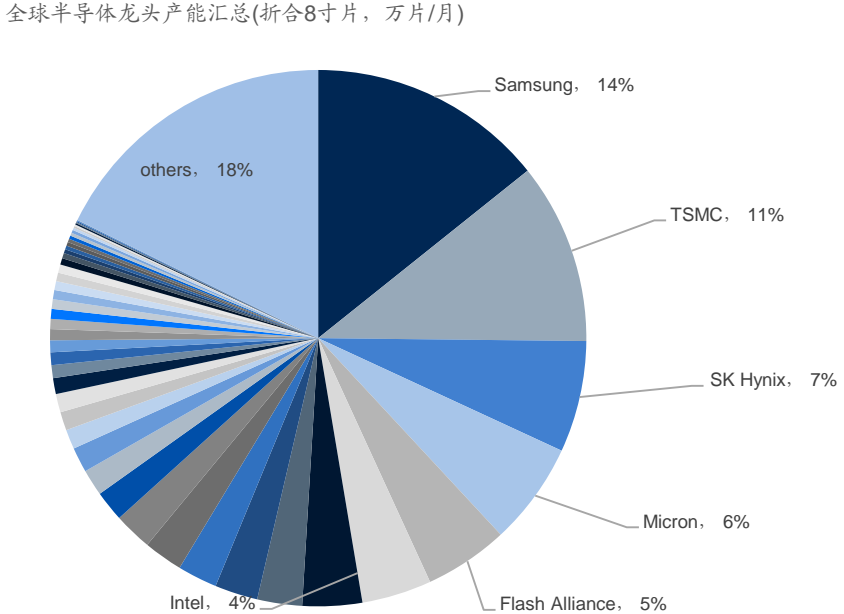
■ 20Q2(E)全球龙头公司预计产能排名前三：Samsung、TSMC、SK Hynix。
其中Samsung预计产能合计306.2万片/月，同比3.0%。TSMC预计产能合计234.1万片/月，同比5.6%。SK Hynix预计产能合计144.2万片/月，同比4.7%。Micron预计产能合计133.0万片/月，同比2.1%。Flash Alliance产能合计108.7万片/月，同比-3.2%。Intel预计产能合计90.3万片/月，同比5.2%。

图19：全球半导体龙头产能汇总(2020-06E)



数据来源：公司公告，国信证券经济研究所整理

图20：全球半导体产能同比增速(%)



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

01

国内外重要半导体指数行情

02

半导体上游-全球设备/材料数据跟踪

03

半导体制造-全球及重点公司晶圆制造产能跟踪

04

半导体下游-全球及重点区域销售跟踪

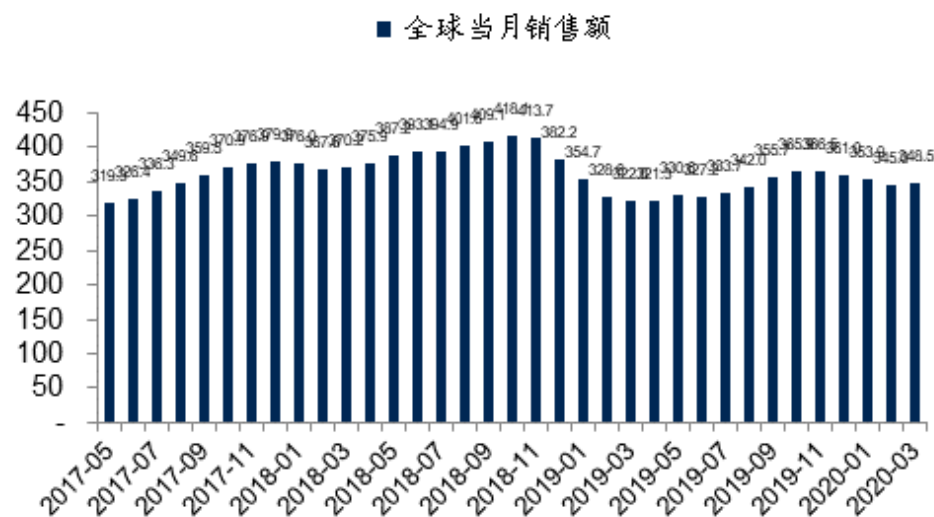
05

全球半导体产业链龙头公司

四、半导体下游-全球半导体销售

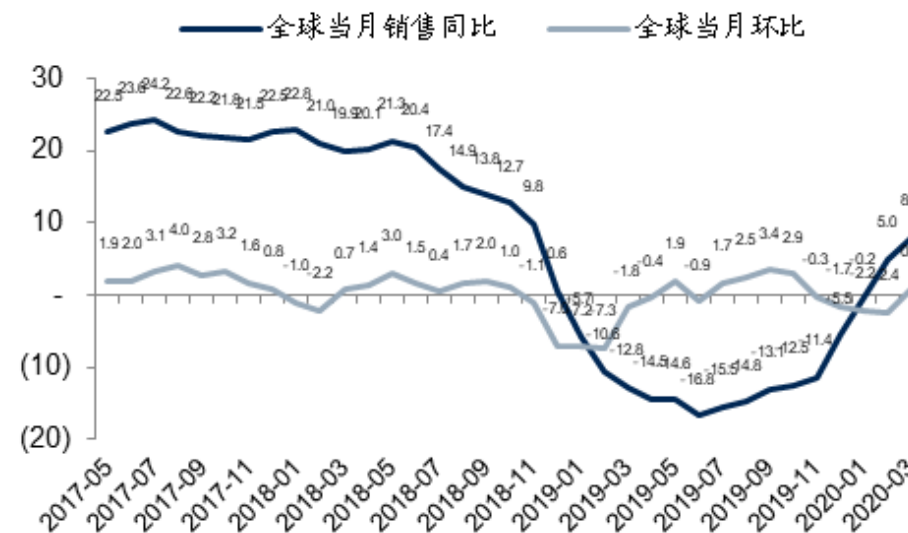
■ 全球半导体销售情况：全球20年3月销售额348.5亿美元，同比+8.0%，1-3月累积销售额1047.4亿美元，同比+4.1%。全球半导体Q1原成长较好，Q2疫情为复苏蒙上阴影。

图21：全球当月销售额



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图22：全球当月销售额同比/环比

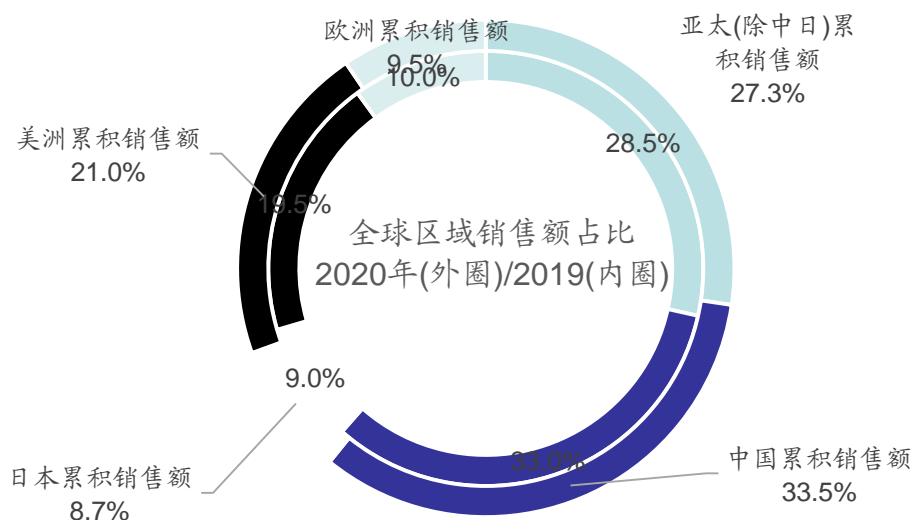


数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

四、半导体下游-全球半导体销售-区域结构

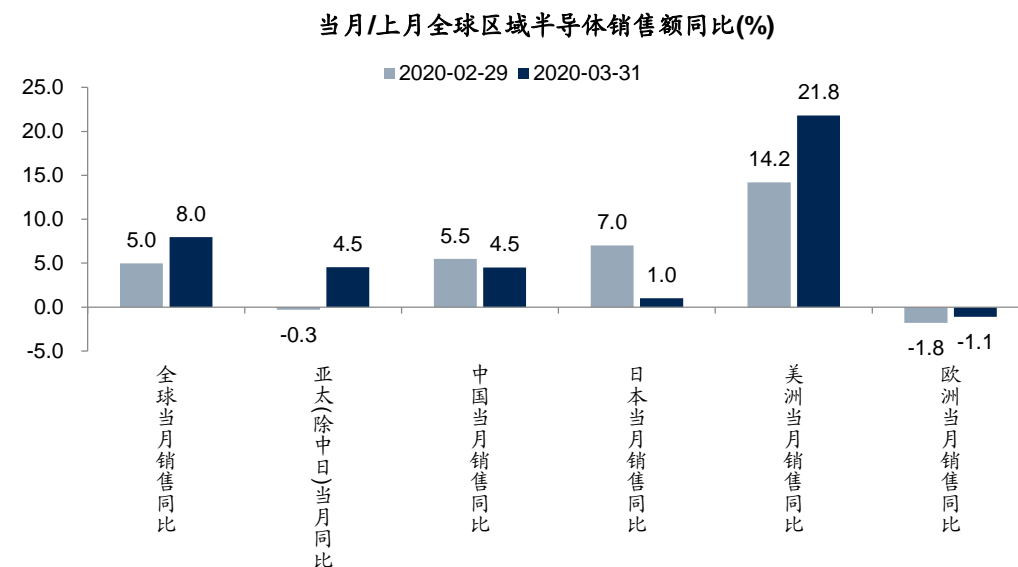
- 全球销售额结构看：中国区域累积销售占比达33.5%，为全球范围内最高，同比19年提升0.5pct。美洲半导体销售连续2个月在各区域中保持较快增长。

图23：全球半导体销售区域占比



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图24：全球半导体销售额3月/2月同比

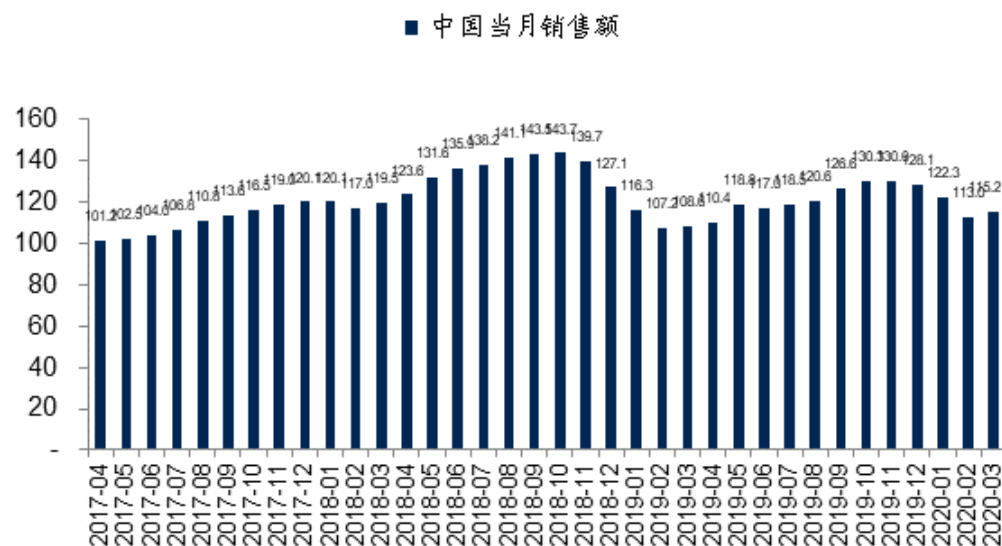


数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

四、半导体下游-全球半导体销售-中国区域

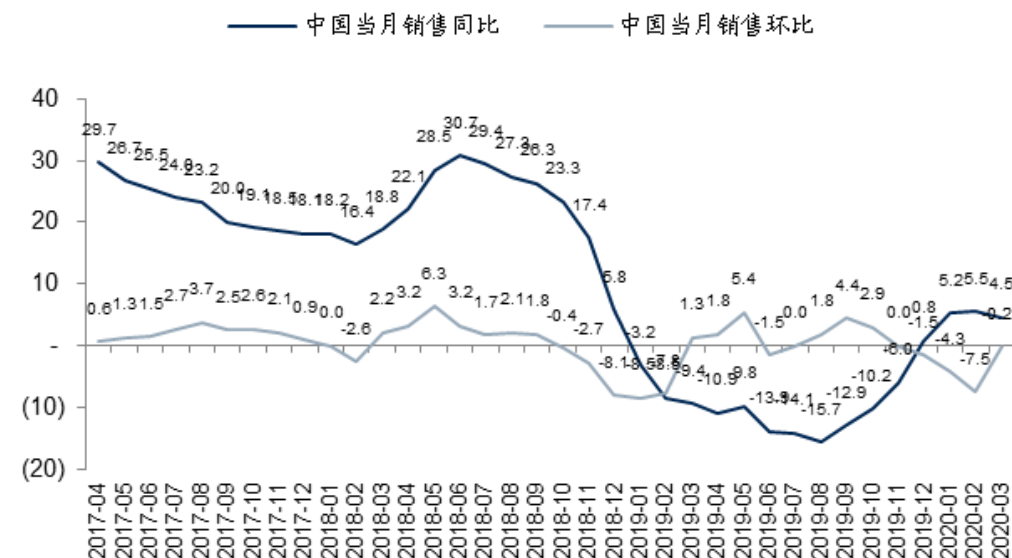
■ 中国半导体销售额情况：中国半导体20年3月销售额115.2亿美元，同比4.5%，1-3月累积销售额350.5亿美元，同比5.5%。虽有疫情影响，中国半导体销售额同比增速略有放缓，但仍然显现较强需求韧性。

图25：中国半导体销售额(亿美元)



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图26：中国半导体销售额当月值同比/环比(%)

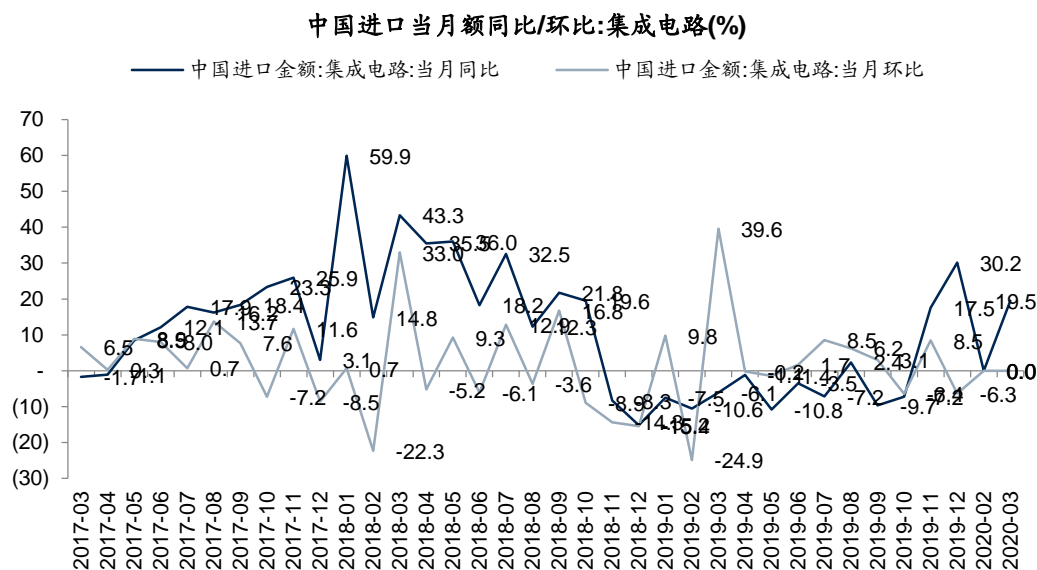


数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

四、半导体下游-全球半导体-中国集成电路进口

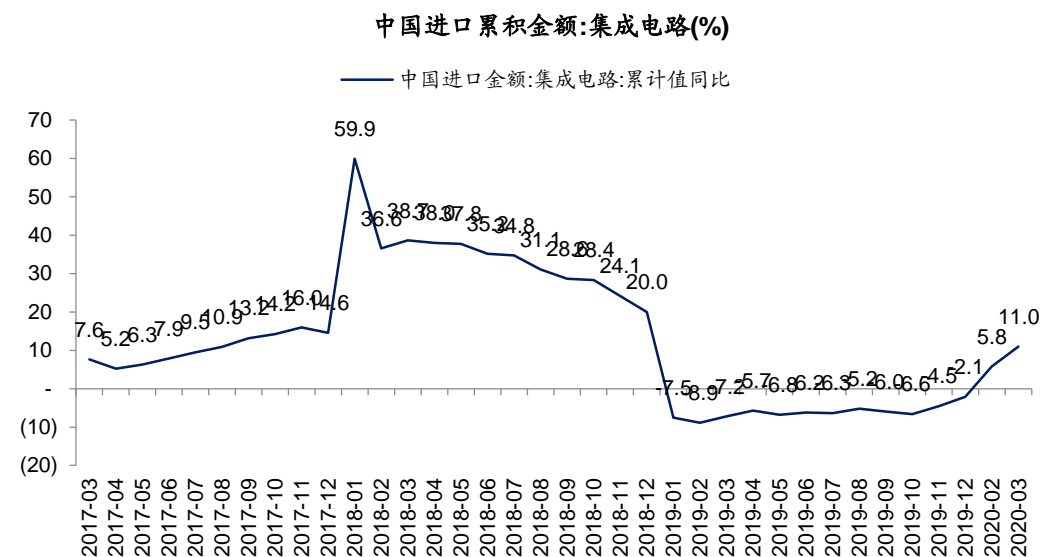
■ 20年03月，中国进口金额:集成电路:当月值291.0亿美元，同比19.5%。20年1-3月，中国集成电路进口累积金额721.1亿美元，同比11.0%。国内集成电路进口增速达到近13个月新高。

图27: 中国进口当月额同比/环比:集成电路(%)



数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图28: 中国进口累积额同比:集成电路(%)



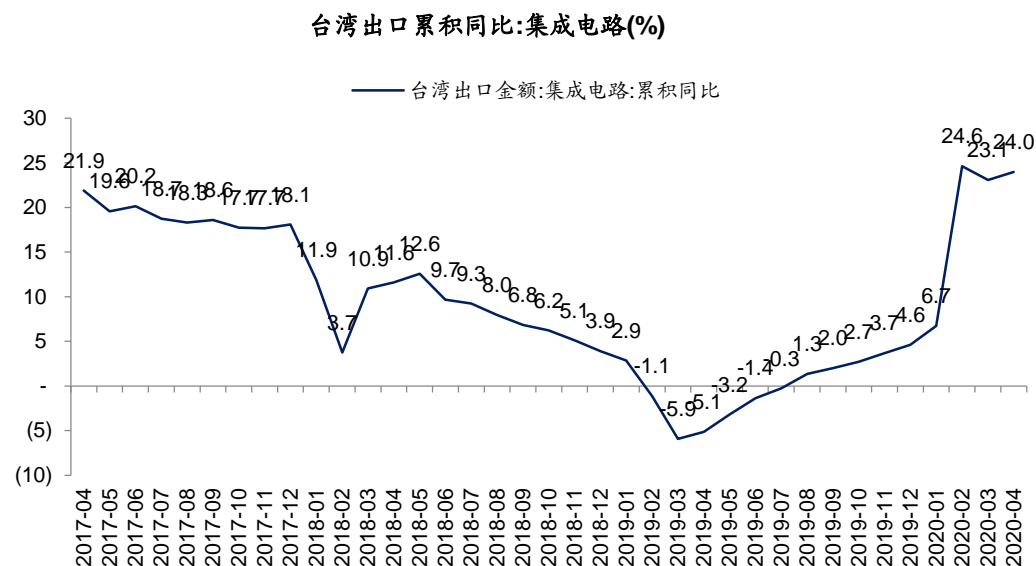
数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

四、半导体下游-全球半导体-台湾集成电路出口

台湾集成电路出口数据具前瞻指示，4月继续呈现较好增长

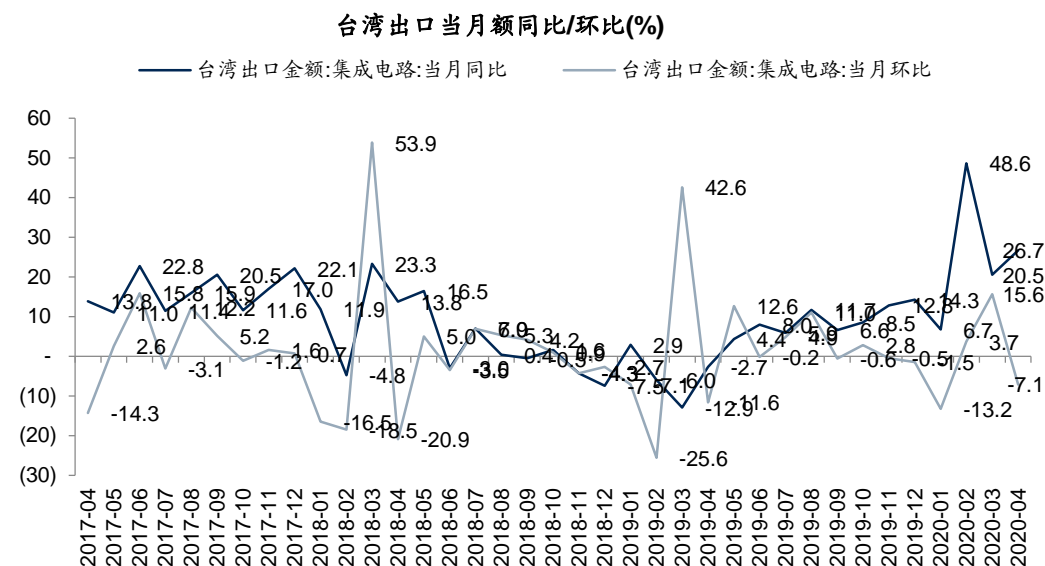
- 20年04月，台湾出口金额:集成电路:当月值90.7亿美元，同比26.7%。20年04月，台湾出口金额:集成电路:累积值354.4亿美元，同比24.0%。
- 20年04月，台湾出口当月金额:电子零组件(不含集成电路)10.0亿美元，同比5.9%。20年04月，台湾出口累积金额:电子零组件(不含集成电路)38.4亿美元，同比-0.3%。

图29: 台湾出口累积金额:集成电路: 同比(%)



数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图30: 台湾出口当月额同比/环比(%)



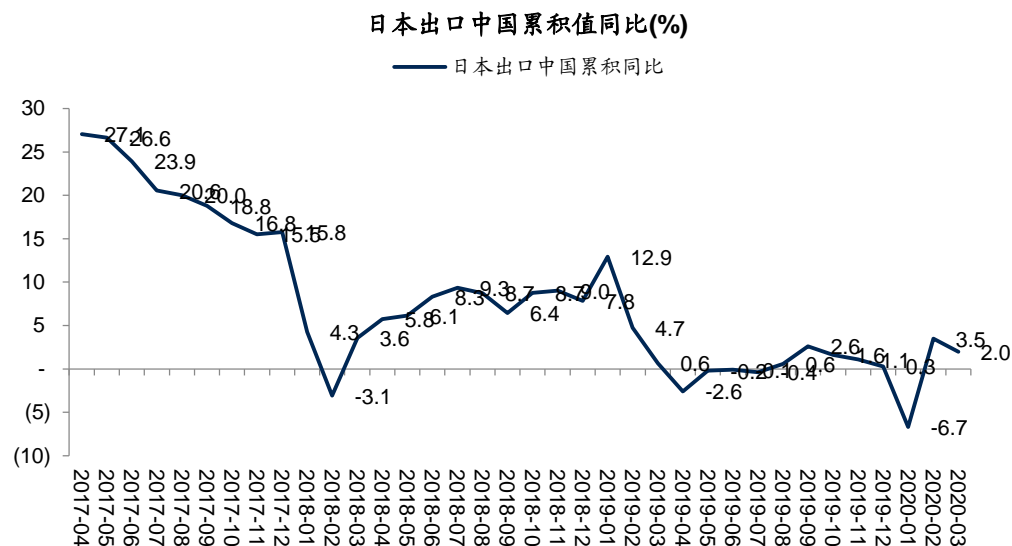
数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

四、半导体下游-全球半导体-日本集成电路出口

日本集成电路出口中国数据，累积同比增速有所放缓，产成品存货显现不足

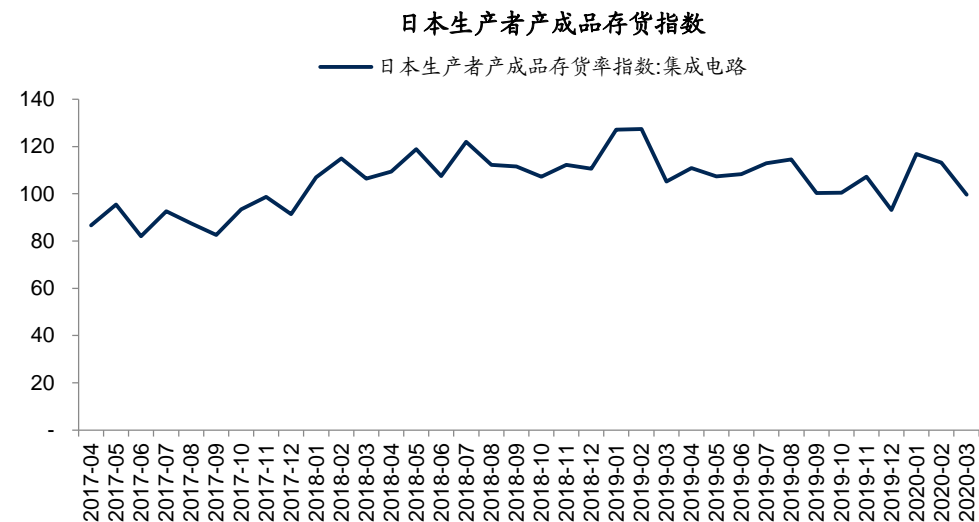
- 20年03月，日本出口中国当月值8.9亿美元，同比-0.8%。20年1-3月，日本出口中国累积值25.7亿美元，同比2.0%。
- 20年03月，日本生产者产成品存货率指数:集成电路99.7，同比-5.2%。

图31：日本出口中国出货同比/环比(%)



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图32：日本出口中国出货同比/环比(%)



数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理

- 01 国内外重要半导体指数行情
- 02 半导体上游-全球设备/材料数据跟踪
- 03 半导体制造-全球及重点公司晶圆制造产能跟踪
- 04 半导体下游-全球及重点区域销售跟踪
- 05 全球半导体产业链龙头公司

五、全球半导体产业链龙头公司重要前瞻

- 截至2020年5月，全球排名前100的半导体相关公司：有3家表示下一季度存在较大不确定性而无法预测，45家发布下一季度业绩指引，其中20家业绩指引同比增长，16家预计营收环比有1~6%增长。

图33：全球主要龙头公司Q1及Q2营收

英文	名字	地区	业务模式	核心产品领域	下一季报 营收指引	下一季报 同比	最新财报 季度营收	最新一期 财报期同 比
INTEL	英特尔	US	半导体产品-IDM	数字芯片	185.0	12.1	198.3	23.5
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台积电	TW	半导体产品-晶圆代工	先进工艺	102.5	32.3	103.1	45.4
SK HYNIX	海力士	KR	半导体产品-IDM	数字芯片			60.4	0.3
BROADCOM	博通	US	半导体产品-Fabless	模拟芯片	57.0	3.3	58.6	1.2
QUALCOMM	高通	US	半导体产品-Fabless	数字芯片	48.0	(50.2)	52.2	4.7
MICRON TECHNOLOGY	美光科技	US	半导体产品-IDM	数字芯片	49.0	2.3	48.0	(17.8)
APPLIED MATERIALS	应用材料	US	半导体设备	前道设备			39.6	11.8
TEXAS INSTRUMENTS	德州仪器	US	半导体产品-IDM	模拟芯片	29.0	(20.9)	33.3	(7.4)
NVIDIA	英伟达	US	半导体产品-Fabless	数字芯片	30.0	35.1	31.1	40.8
TOKYO ELECTRON	东京电子	JP	半导体设备				29.7	2.5
ASMLNV	阿斯麦控股	NL	半导体设备	前道设备			26.9	6.4
LAM RESEARCH	泛林集团	US	半导体设备				25.0	2.6
STMICROELECTRONICS NV	意法半导体	IT	半导体产品-IDM	模拟芯片	20.0	(8.0)	22.3	7.5
INFINEON TECHNOLOGIES AG	英飞凌科技	DE	半导体产品-IDM	模拟芯片	23.1	1.9	21.9	(2.8)
NXP SEMICONDUCTORS NV	恩智浦半导体	US	半导体产品-IDM	模拟芯片	18.0	(18.8)	20.2	(3.5)
MEDIATEK	联发科	TW	半导体产品-Fabless	数字芯片			20.2	18.2
ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	US	半导体产品-Fabless	数字芯片	18.5	20.8	17.9	40.4
RENESAS ELECTRONICS	瑞萨电子	JP	半导体产品-IDM	模拟芯片			16.4	20.3
KLA	KLA	US	半导体设备		14.0	11.2	14.2	29.8
UNITED MICROELECTRONICS	联华电子	TW					14.0	32.8
MICROCHIP TECHNOLOGY	微芯科技	US	半导体产品-IDM	模拟芯片	12.5	(5.7)	13.3	(0.3)

五、全球半导体产业链龙头公司重要前瞻

■ 截至2020年5月，6家公布最近季度财报的全球存储类公司，5家实现营收同比增长，其中台湾企业均实现较大幅度增长，同时美光公布Q2营收指引中值，预计同比增长2.3%(Q1同比-17.8%)。

图34：全球存储龙头公司Q1及Q2营收

英文	名字	地区	核心应用	下一季报 营收指引	下一季报 同比	最新财报 季度营收	最新一期 财报期同 比	最新一期 财报期环 比
SK HYNIX	海力士	KR	存储芯片			60.4	0.3	2.4
MICRON TECHNOLOGY	美光科技	US	存储芯片	49.0	2.3	48.0	(17.8)	(6.7)
NANYA TECHNOLOGY	南亚科技	TW	存储芯片			4.8	29.8	11.3
WINBOND ELECTRONICS	华邦电子	TW	存储芯片			3.8	8.6	(6.1)
MACRONIX	旺宏	TW	存储芯片			3.1	59.8	(0.5)
A-DATA TECHNOLOGY	威刚科技	TW	存储芯片			2.4	14.8	2.1

■ 截至2020年5月，9家公布最近季度财报的全球功率或射频龙头公司，2家实现营收同比增长，8家公布下一季度指引中值，2家预计同比实现增长，2家同比下跌收窄。

图35：全球功率或射频龙头公司Q1及Q2营收

英文	名字	地区	核心应用	下一季报 营收指引	下一季报 同比	最新财报 季度营收	最新一期 财报期同 比	最新一期 财报期环 比
BROADCOM	博通股份	US	功率或射频	57.0	3.3	58.6	1.2	1.4
INFINEON TECHNOLOGIES AG	英飞凌科技	DE	功率或射频	23.1	1.9	21.9	(2.8)	3.2
INXP SEMICONDUCTORS NV	恩智浦半导体	US	功率或射频	18.0	(18.8)	20.2	(3.5)	(12.2)
ANALOG DEVICES	模拟器件	US	功率或射频	13.5	(11.6)	13.0	(15.4)	(9.7)
ON SEMICONDUCTOR	安森美半导体	US	功率或射频	11.8	(12.4)	12.8	(7.8)	(8.8)
SKYWORKS SOLUTIONS	思佳讯解决方案	US	功率或射频	6.9	(10.0)	7.7	(5.5)	(14.5)
QORVO	Qorvo股份	US	功率或射频	7.3	(5.9)	7.9	15.7	(9.4)
DIALOG SEMICONDUCTOR	Dialog半导体	DE	功率或射频	2.8	(42.9)	2.5	(15.7)	(34.7)
SANKEN ELECTRIC	三垦电气	JP	功率或射频			3.8	(1.4)	2.1

五、全球半导体产业链龙头公司重要前瞻

■ 截至2020年5月，6家公布最近季度财报的全球半导体材料公司，4家实现营收同比增长。

图36：全球半导体材料龙头公司Q1及Q2营收

英文	名字	地区	业务模式	下一季报 营收指引	下一季报 同比	最新财报 季度营收	最新一期 财报期同 比	最新一期 财报期环 比
GLOBALWAFERS D	环球晶圆	TW	半导体材料			4.5	(11.3)	1.3
SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES	Shinko Electric	JP	半导体材料			3.7	18.4	6.5
SILTRONIC AG	Siltronic	DE	半导体材料			3.3	(17.8)	(1.8)
GRINM ADVANCED MATERIAL CO-A	有研新材	CN	半导体材料			3.2	34.2	(30.7)
TAIWAN SURFACE MOUNTING TECH	台表科	TW	半导体材料			2.8	1.1	(13.1)
TOKYO OHKA KOGYO D	东京应化工业	JP	半导体材料			2.5	18.2	(1.7)

五、全球半导体产业链龙头公司重要前瞻

- 截至2020年5月，13家公布最近季度财报的全球半导体设备龙头，全部实现营收同比增长，其中8家预告下一期营收中，7家预告将实现同比增长。

图37：全球半导体设备Q1及Q2营收

英文	名字	地区	业务模式	下一季报 营收指引	下一季报 同比	最新财报 季度营收	最新一期 财报期同 比	最新一期 财报期环 比
APPLIED MATERIALS	应用材料	US	半导体设备			39.6	11.8	(4.9)
TOKYO ELECTRON	东京电子	JP	半导体设备			29.7	2.5	9.2
ASMLNV	阿斯麦控股	NL	半导体设备			26.9	6.4	(39.8)
LAM RESEARCH	泛林集团	US	半导体设备			25.0	2.6	(3.1)
KLA	KLA	US	半导体设备	14.0	11.2	14.2	29.8	(5.7)
TERADYNE	泰瑞达	US	半导体设备	7.5	32.1	7.0	42.6	7.6
ADVANTEST	爱德万测试	JP	半导体设备	6.5	8.2	6.3	7.9	(2.6)
MKS INSTRUMENTS	MKS Instruments	US	半导体设备	4.9	2.3	5.4	15.6	7.2
ENTEGRIS	Entegris	US	半导体设备	4.2	10.9	4.1	5.4	(3.4)
ASM INTERNATIONAL NV	ASM国际	NL	半导体设备	3.5	(13.5)	3.6	26.9	(19.2)
ULTRA CLEAN HOLDINGS	Ultra Clean控股	US	半导体设备	3.1	16.8	3.2	23.4	12.0
FUJII/AICHI	富士	JP	半导体设备			3.2	4.7	0.5
CABOT MICROELECTRONICS	Cabot微电子	US	半导体设备			2.8	7.1	0.4
BROOKS AUTOMATION	布鲁克斯自动化	US	半导体设备	2.1	1.8	2.2	11.0	4.6

五、全球半导体产业链龙头公司重要前瞻

- 截至2020年5月，在全球主要的IDM、封测及代工龙头中，Q1中11家同比实现增长，3家同比下滑，在公布业绩预告的7家中，5家预计Q2能实现同比增长，2家预计将同比下滑。

图38：全球IDM、封测及代工龙头Q1及Q2营收

	英文	名字	地区	业务模式	下一季报 营收指引	下一季报 同比	最新财报 季度营收	最新一期 财报期同比	最新一期 财报期环比	指引对应 去年同期 季报营收
INTC US Equity	INTEL	英特尔	US	半导体产品-IDM	185.0	12.1	198.3	23.5	(1.9)	16505.0
2330 TT Equity	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台积电	TW	半导体产品-晶圆代工	102.5	32.3	103.1	45.4	(0.9)	7746.6
AMKR US Equity	AMKOR TECHNOLOGY	安靠技术	US	半导体产品-封测	10.5	17.3	11.5	28.8	(2.2)	895.3
981 HK Equity	SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	中芯国际	HK	半导体产品-晶圆代工	9.4	19.0	9.0	35.3	7.8	790.9
600584 CH Equity	JCET GROUP D-A	长电科技	CN	半导体产品-封测			8.2	22.3	(21.4)	679.3
6239 TT Equity	POWERTECH TECHNOLOGY	力成	TW	半导体产品-封测			6.2	33.4	(1.4)	484.7
002156 CH Equity	TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	通富微电	CN	半导体产品-封测			3.1	26.7	(1.2)	283.5
TSEM IT Equity	TOWER SEMICONDUCTOR	塔尔半导体	IL	半导体产品-晶圆代工	3.1	1.3	3.0	(3.2)	(1.8)	306.1
5347 TT Equity	VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	世界	TW	半导体产品-晶圆代工			2.6	16.2	8.2	222.4
002185 CH Equity	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	华天科技	CN	半导体产品-封测			2.4	(4.4)	(14.5)	312.0
2449 TT Equity	KING YUAN ELECTRONICS D	京元电子	TW	半导体产品-封测			2.3	36.2	(0.9)	195.8
1347 HK Equity	HUA HONG SEMICONDUCTOR	华虹半导体	HK	半导体产品-晶圆代工	2.2	(4.4)	2.0	(8.1)	(16.4)	230.0
MX US Equity	MAGNACHIP SEMICONDUCT	美格纳半导体	US	半导体产品-IDM	2.0	(4.0)	1.2	12.3	(39.8)	205.1
3711 TT Equity	ASE TECHNOLOGY	日月光投资控股	TW	半导体产品-封测			32.6	13.1	15.5	2916.8

五、全球半导体产业链龙头公司重要前瞻

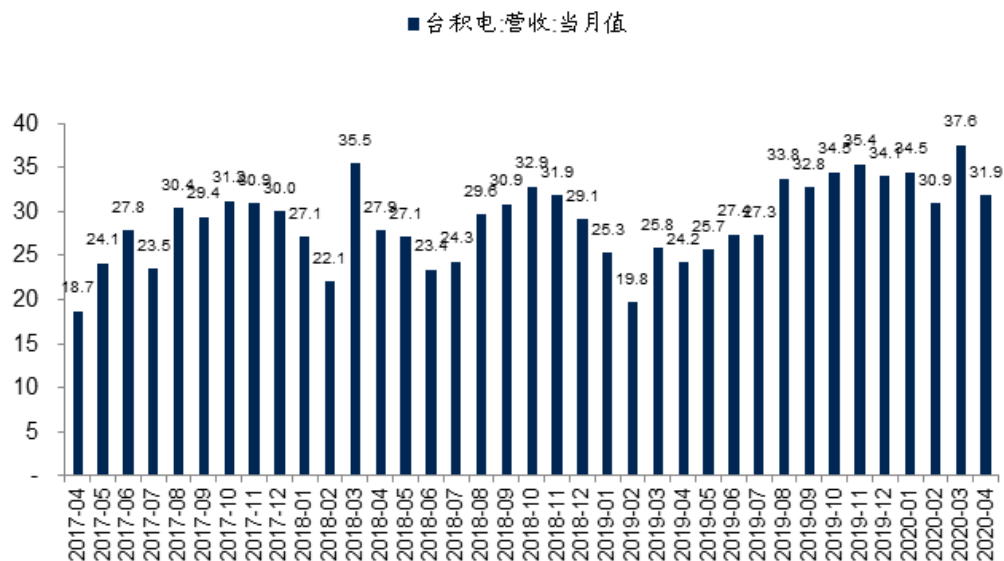
台湾半导体龙头公司数据显现，上游晶圆代工、化合物射频代工、封测环节，及存储类相关龙头公司营收表现出色。其中稳懋、旺宏已连续多月保持同比较高增速，反映来自射频及存储端的需求十分活跃，主要系来自5G、TWS等产品需求的拉动作用。而同时手机芯片IC设计代表企业联发科，同比增速下滑，预示全球手机Q2的需求正受到疫情影响而有所放缓。

- 1、20年04月台积电(全球集成电路代工龙头):营收:当月值31.9亿美元，同比31.8%。
- 2、20年04月稳懋(全球化合物半导体代工龙头):营收:当月值0.7亿美元，同比61.0%。
- 3、20年04月日月光(全球封测龙头):营收:当月值11.7亿美元，同比24.6%。
- 4、20年04月联发科(全球手机设计IC大厂):营收:当月值6.8亿美元，同比-2.2%。
- 5、20年04月旺宏(全球存储大厂):营收:当月值1.1亿美元，同比101.9 %

五、全球半导体产业链龙头公司重要前瞻

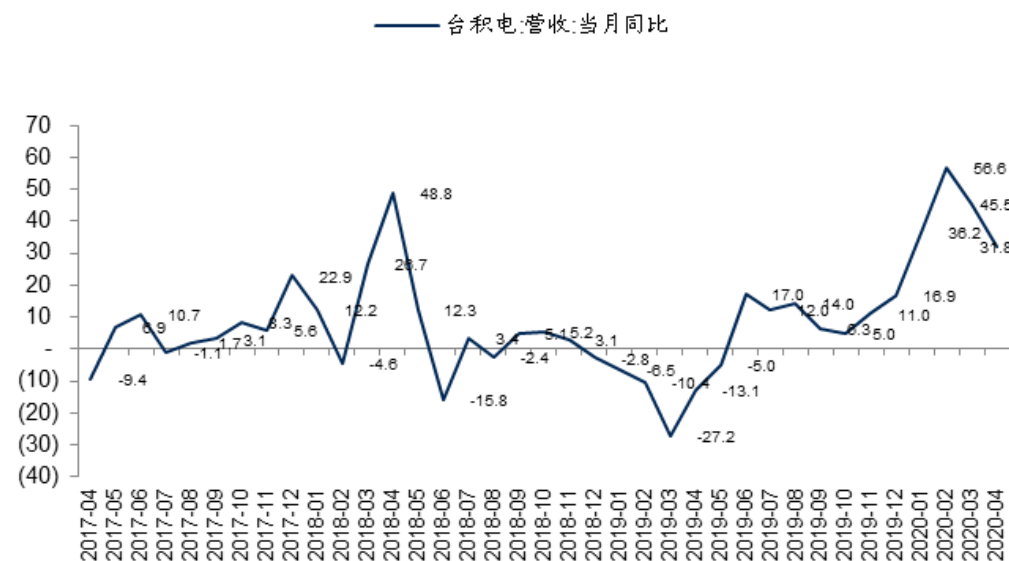
■ 20年04月台积电:营收:当月值31.9亿美元, 同比31.8%。

图39: 台积电当月营收(亿美元)



数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图40: 台积电当月同比(%)

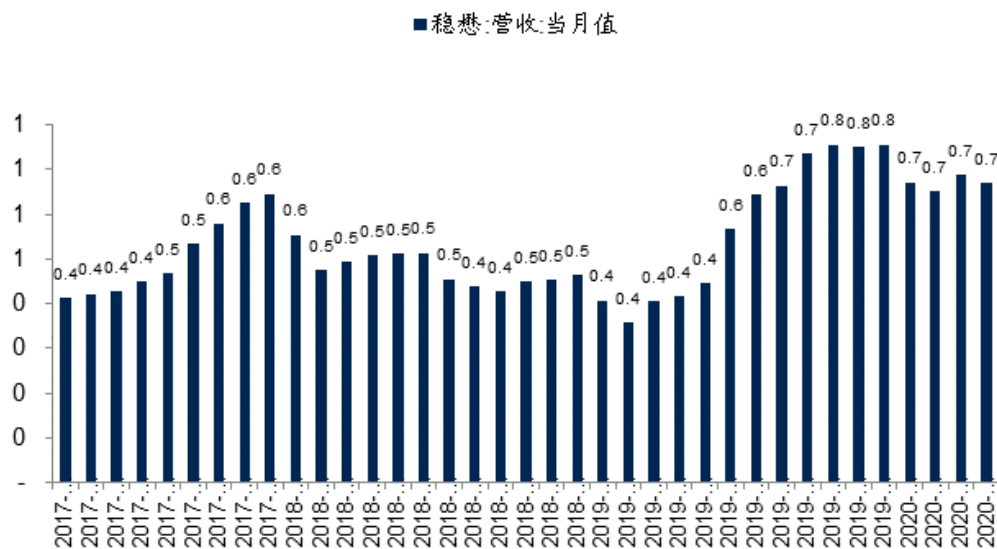


数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

五、全球半导体产业链龙头公司重要前瞻

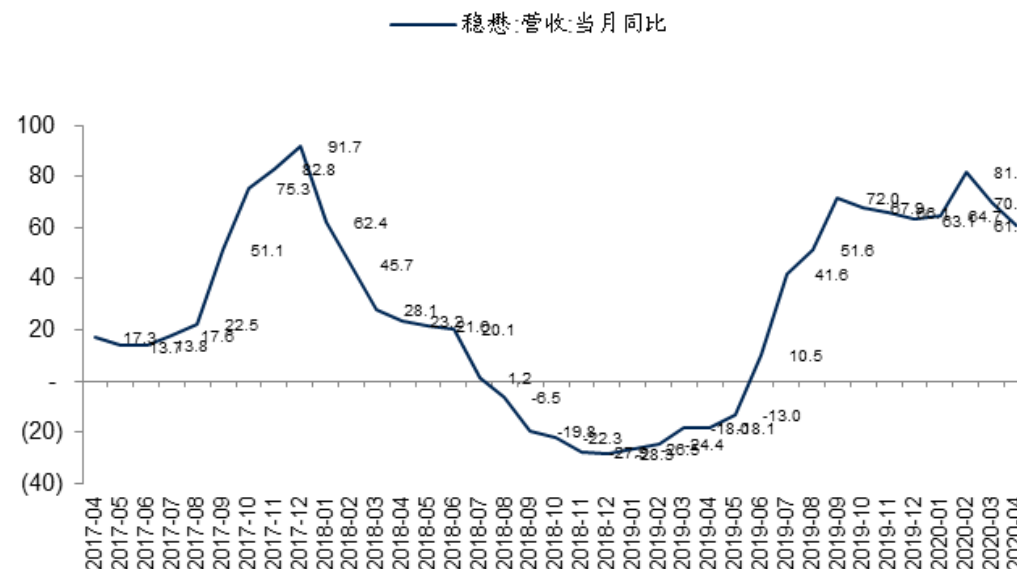
■ 20年04月稳懋:营收:当月值0.7亿美元, 同比61.0%。

图41: 稳懋当月营收(亿美元)



数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图42: 稳懋当月同比(%)

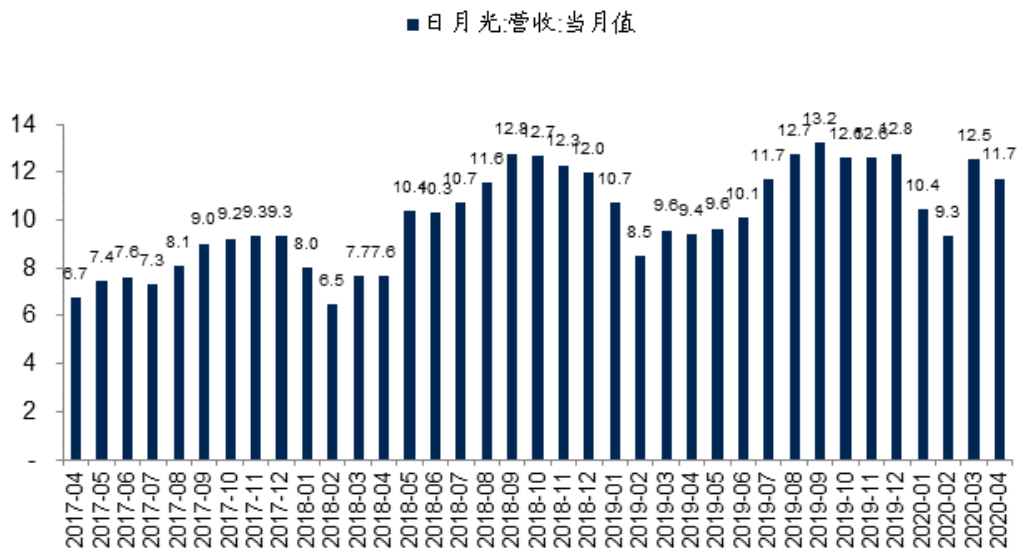


数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

五、全球半导体产业链龙头公司重要前瞻

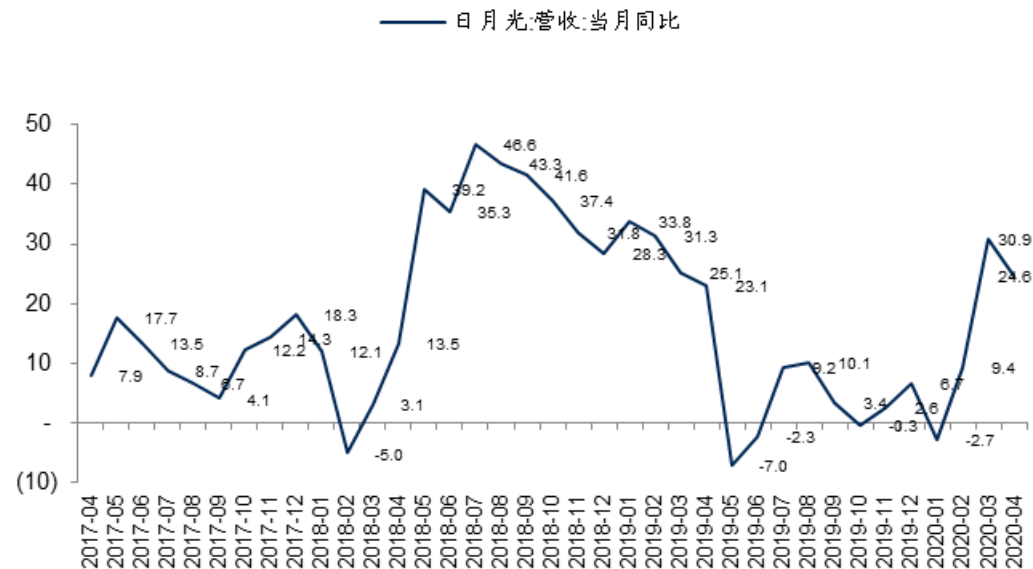
■ 20年04月日光:营收:当月值11.7亿美元，同比24.6%。

图43: 日光当月营收(亿美元)



数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图44: 日光当月同比(%)

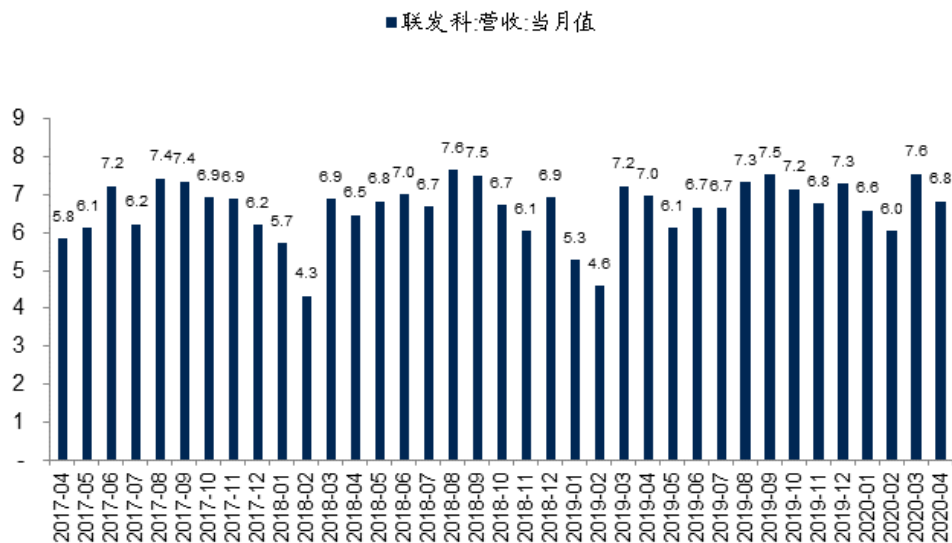


数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

五、全球半导体产业链龙头公司重要前瞻

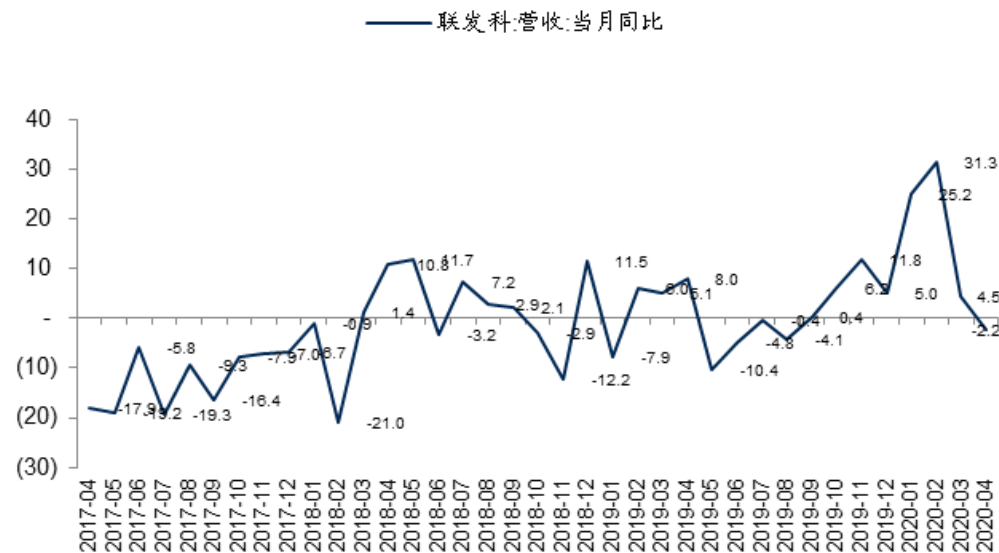
■ 20年04月联发科:营收:当月值6.8亿美元, 同比-2.2%。

图45: 联发科当月营收(亿美元)



数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

图46: 联发科当月同比(%)



数据来源: Wind, 国信证券经济研究所整理

风险提示

- 1、宏观经济政策波动导致需求恢复不及预期。
- 2、国产半导体自主可控不及预期；
- 3、贸易战加剧导致产业链核心受制于人；

国信证券投资评级

类别	级别	定义
股票投资评级	买入	预计6个月内，股价表现优于市场指数20%以上
	增持	预计6个月内，股价表现优于市场指数10%-20%之间
	中性	预计6个月内，股价表现介于市场指数±10%之间
	卖出	预计6个月内，股价表现弱于市场指数10%以上
行业投资评级	超配	预计6个月内，行业指数表现优于市场指数10%以上
	中性	预计6个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
	低配	预计6个月内，行业指数表现弱于市场指数10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

风险提示

本报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有，仅供我公司客户使用。未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。



国信证券经济研究所
GUOSEN SECURITIES ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE

全球视野 本土智慧
GLOBAL VIEW LOCAL WISDOM